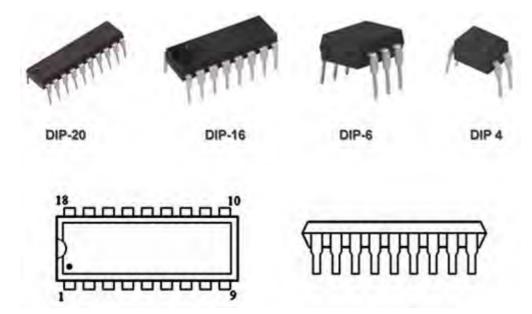
ТИПЫ КОРПУСОВ МИКРОСХЕМ

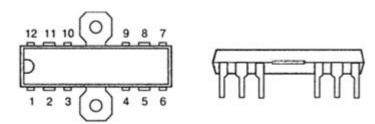
DIP PDIP SIP TO92 TO-220 PENTAWATT DPAK SO SOIC SOJ QFP TQFP (Thin QFP), QFP, LQFP (Low-profile QFP)
QFN TSOP SSOP PLCC ZIP ZIP12, ZIP16, ZIP17, ZIP19, ZIP20, ZIP24, ZIP40

Корпус интегральной микросхемы (ИМС) — это герметичная конструкции, предназначенная для защиты кристалла интегральной схемы от внешних воздействий и для электрического соединения с внешними цепями. Длина корпуса микросхем зависит от числа выводов. Давайте рассмотрим некоторые типы корпусов, которые наиболее часто применяются радиолюбителями.

DIP (Dual In-line Package) - тип корпуса микросхем, микросборок и некоторых других электронных компонентов для монтажа в отверстия печатной платы, является самым распространенным типом корпусов. Имеет прямоугольную форму с двумя рядами выводов по длинным сторонам. Может быть выполнен из пластика или керамики. В обозначении корпуса указывается число выводов. В корпусе DIP могут выпускаться различные полупроводниковые или пассивные компоненты — микросхемы, сборки диодов, ТТЛ-логика, генераторы, усилители, ОУ и прочие... Компоненты в корпусах DIP обычно имеют от 4 до 40 выводов, возможно есть и больше. Большинство компонентов имеет шаг выводов 2.54 миллиметра и расстояние между рядами 7.62 или 15.24 миллиметра.



Одной из разновидностью корпуса DIP является корпус QDIP на таком корпусе 12 выводов и обычно имеются лепестки для крепления микросхемы на радиатор, вспомните микросхему К174УН7.

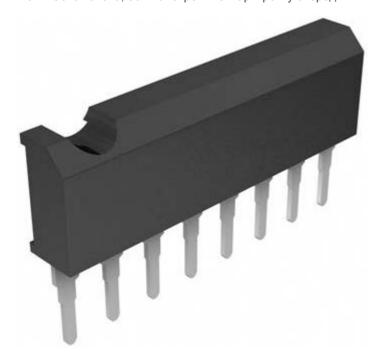


Разновидностью DIP является PDIP - (Plastic Dual In-line Package) - корпус имеет форму прямоугольника, снабжен выводами,

предназначенными преимущественно для монтажа в отверстия. Существуют две разновидности корпуса: узкая, с расстоянием между выводами 7.62 мм и широкая, с расстоянием между выводами 15.24 мм. Различий между DIP и PDIP в плане корпуса нет, PDIP обычно изготавливается из пластика, CDIP - из керамики. Если у микросхемы много выводов, например 28 и более, то корпус может быть широким.



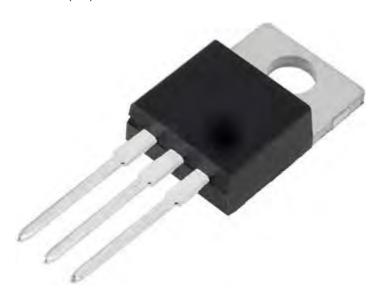
SIP (Single In-line Package) – плоский корпус для вертикального монтажа в отверстия печатной платы, с одним рядом выводов по длинной стороне. Обычно в обозначении также указывается число выводов. Нумерация выводов данных типов микросхем начинается слева, если смотреть на маркировку спереди.



ТО92 – распространённый тип корпуса для маломощных транзисторов и других полупроводниковых приборов с двумя или тремя выводами, в том числе и микросхем, например интегральных стабилизаторов напряжения. В СССР данный тип корпуса носил обозначение КТ-26.



TO220 — тип корпуса для транзисторов, выпрямителей, интегральных стабилизаторов напряжения и других полупроводниковых приборов малой и средней мощности. Нумерация выводов для разных элементов может отличаться, у транзисторов одно обозначение, у стабилизаторов напряжения другое...



PENTAWATT – Содержит 5 выводов, в таких корпусах выпускаются, например усилители НЧ (TDA2030, 2050...), или стабилизаторы напряжения.



DPAK - (TO-252, KT-89) корпус для размещения полупроводниковых устройств. D2PAK аналогичен корпусу DPAK, но больше по размеру; в основном эквивалент TO220 для SMD-монтажа, бывают трёх, пяти, шести, семи или восьмивыводные.







SO (Small Outline) пластиковый корпус малого размера. Корпус имеет форму прямоугольника, снабжен выводами, предназначенными для монтажа на поверхность. Существуют две разновидности корпуса: узкая, с шириной корпуса 3.9 мм (0.15 дюйма) и широкая, с шириной корпуса 7.5 мм (0.3 дюйма).



SOIC (Small-Outline Integrated Circuit) - предназначен для поверхностного монтажа, по сути это то же, что и SO. Имеет форму прямоугольника с двумя рядами выводов по длинным сторонам. Как правило, нумерация выводов одинаковых микросхем в корпусах DIP и SOIC совпадает. Помимо сокращения SOIC для обозначения корпусов этого типа могут использоваться буквы SO, а также SOP (Small-Outline Package) и число выводов. Такие корпуса могут иметь различную ширину. Обычно обозначаются как SOxx-150, SOxx-208 и SOxx-300 или пишут SOIC-хх и указывают какому чертежу он соответствует. Данный тип корпусов схож с QSOP.

PDIP/SOIC



Также существует версия корпуса с загнутыми под корпус (в виде буквы J) выводами. Такой тип корпуса обозначается как **SOJ** (Small-Outline J-leaded).



QFP (Quad Flat Package) - семейство корпусов микросхем, имеющих планарные выводы, расположенные по всем четырём сторонам. Форма основания микросхемы — прямоугольная, а зачастую используется квадрат. Корпуса обычно различаются только числом выводов, шагом, размерами и используемыми материалами. **BQFP**отличается расширениями основания по углам микросхемы, предназначенными для защиты выводов от механических повреждений до запайки.



В это семейство входят корпуса **TQFP** (**Thin QFP**), QFP, **LQFP** (**Low-profile QFP**). Микросхемы в таких корпусах предназначены только для поверхностного монтажа; установка в разъём или монтаж в отверстия штатно не предусмотрена, хотя переходные коммутационные устройства существуют. Количество выводов QFP микросхем обычно не превышает 200, с шагом от 0,4 до 1,0 мм. Габаритные размеры корпусов и расстояние между выводами можно посмотреть







QFN (Quad-flat no-leads) – у таких корпусов, так же как и у корпусов SOJ, вывода загнуты под корпус. Габаритные размеры и расстояние между выводами корпусов QFN можно посмотреть Данный корпус схож с типом корпусов **MLF**, у них вывода расположены по периметрии и снизу.





TSOP (Thin Small-Outline Package) – данные корпуса очень тонкие, низкопрофильные, являются разновидностью SOP микросхем. Применяются в модулях оперативной памяти DRAM и для чипов флеш-памяти, особенно для упаковки низковольтных микросхем из-за их малого объёма и большого количества штырьков (контактов). В более современных модулях памяти такие корпуса уже не применяются, их заменили корпуса типа BGA. Обычно различают два типа корпусов, они представлены ниже на фото.





PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) и CLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier) - представляют собой квадратный корпус с расположенными по краям контактами, предназначенный для установки в специальную панель (часто называемую «кроваткой»). В настоящее время широкое распространение получили микросхемы флэш-памяти в корпусе PLCC, используемые в качестве микросхемы BIOS на системных платах. Габаритные размеры корпусов и расстояние между выводами можно посмотреть



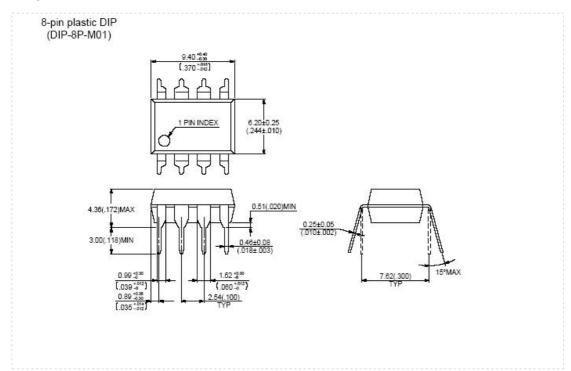
ZIP (Zigzag-In-line Package) - плоский корпус для вертикального монтажа в отверстия печатной платы со штырьковыми выводами, расположенными зигзагообразно. Бывают ZIP12, ZIP16, ZIP17, ZIP19, ZIP20, ZIP24, ZIP40 цифры означают количество выводов и тип корпуса, кроме этого они различаются габаритами корпусов, а так же расстоянием между выводами.

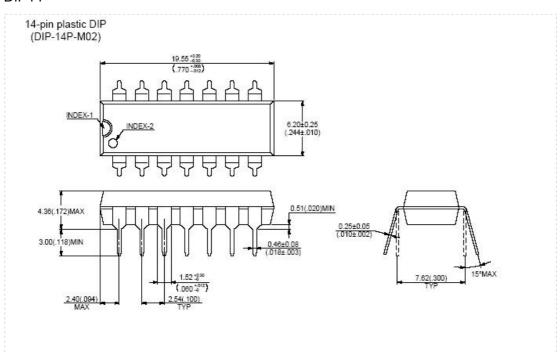


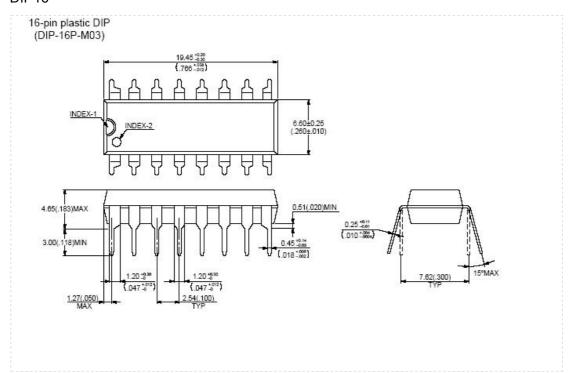
Габаритные размеры корпусов и расстояние между выводами смотрите ниже

Корпус DIP. Чертежи корпусов импортных микросхем.

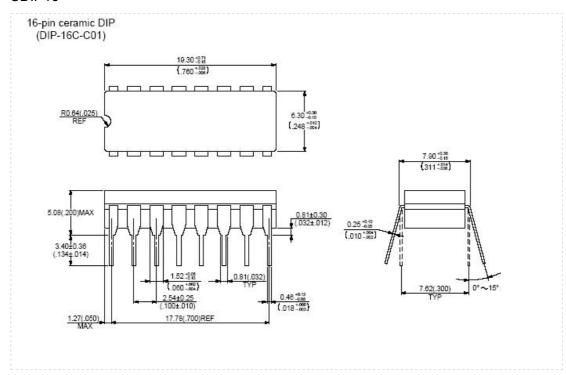
DIP8

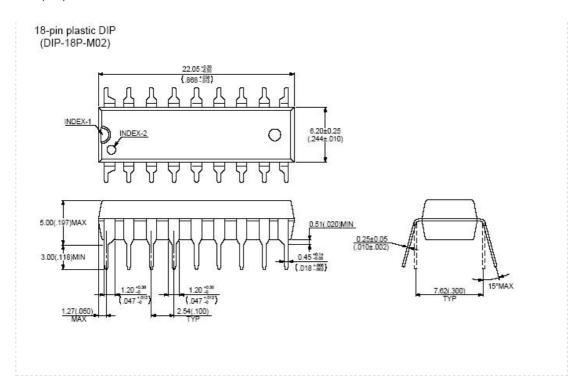




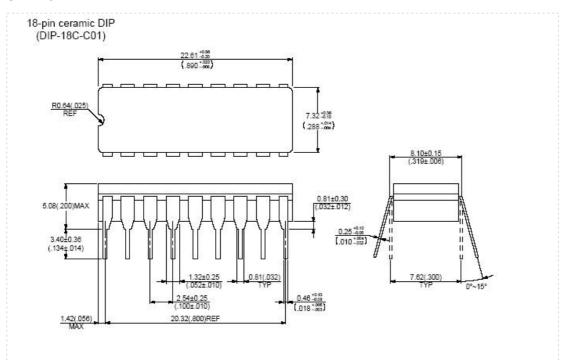


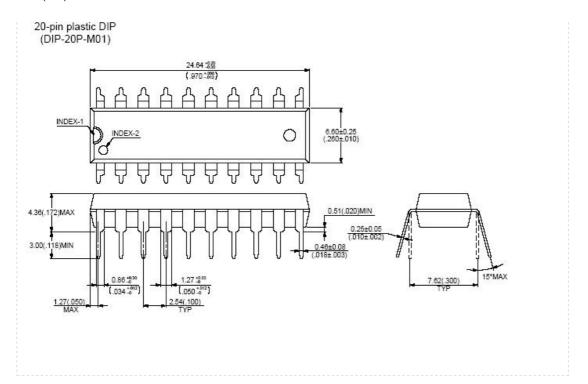
CDIP16



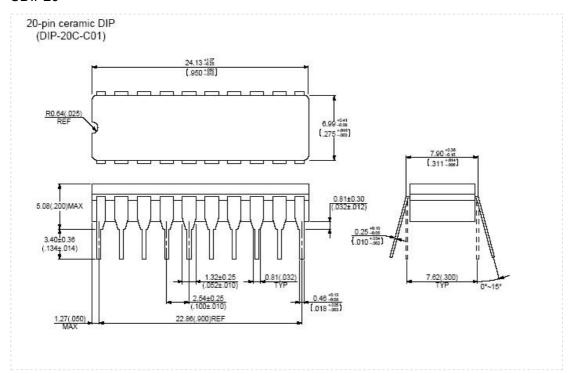


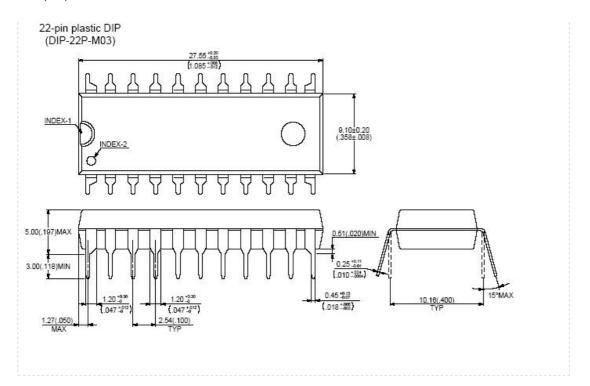
CDIP18

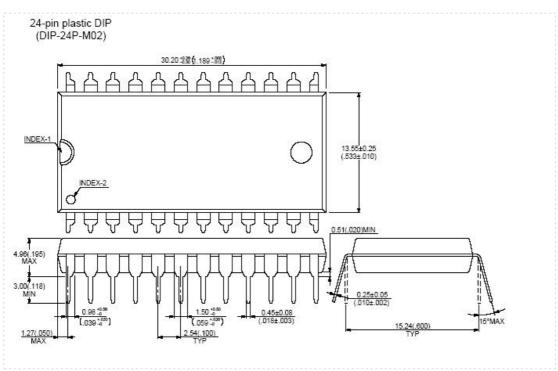


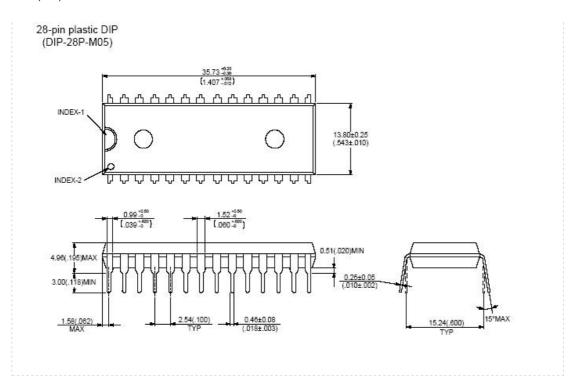


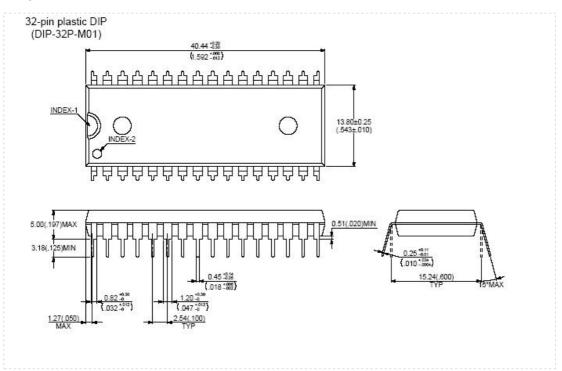
CDIP20

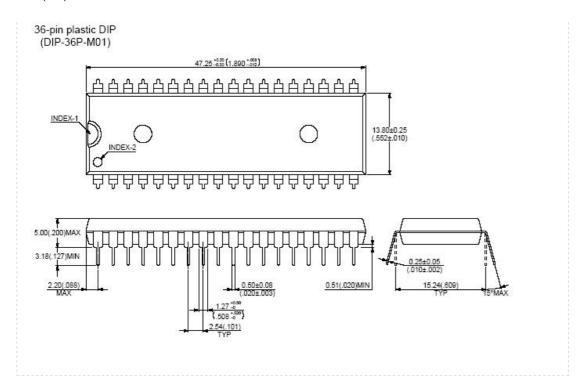


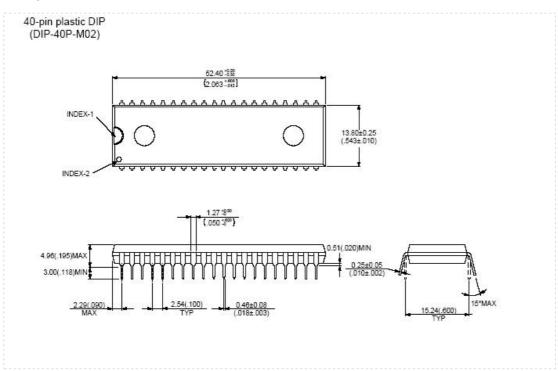


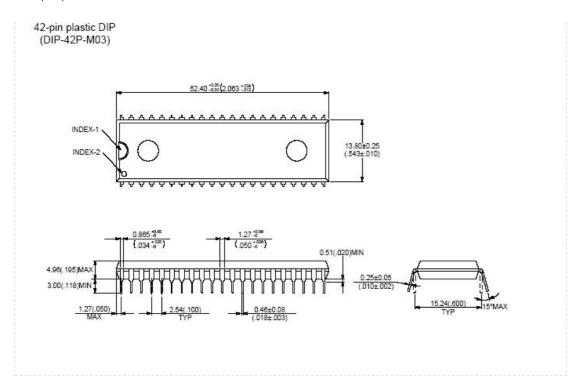


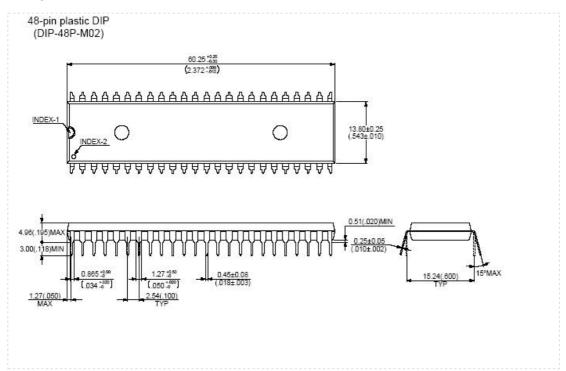


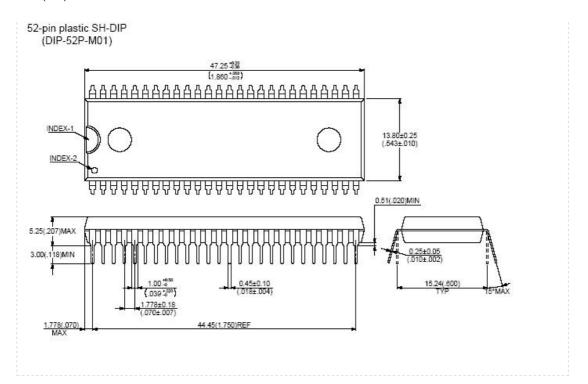


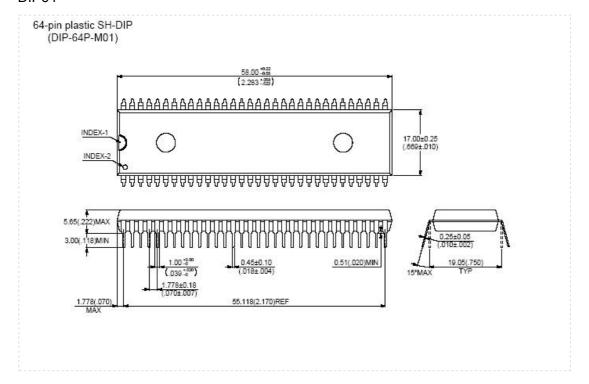






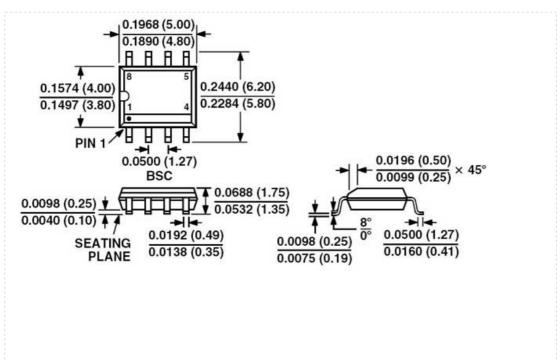




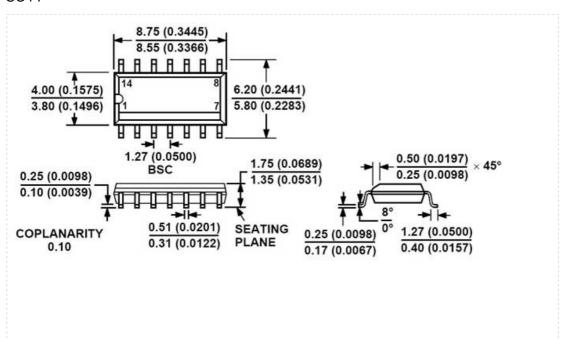


Корпус SOIC. Чертежи корпусов импортных микросхем.

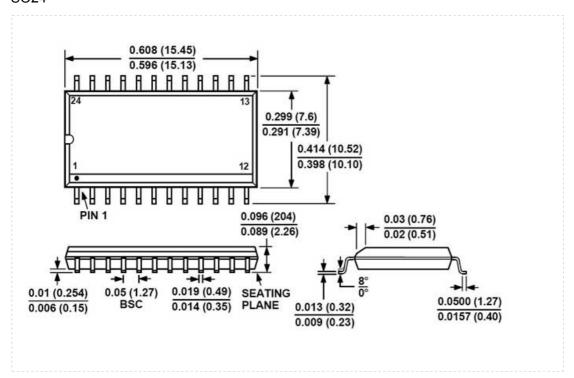
SO8



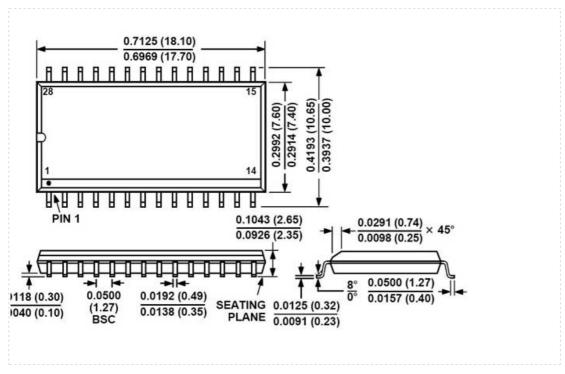
SO14

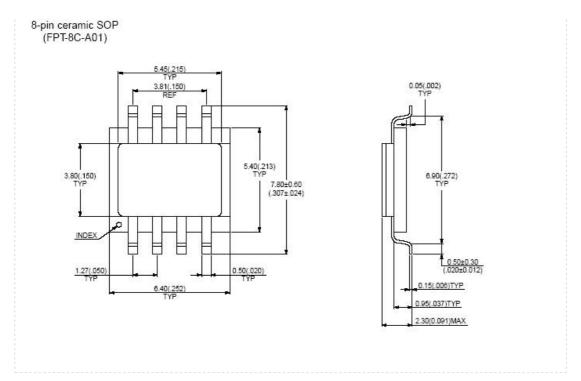


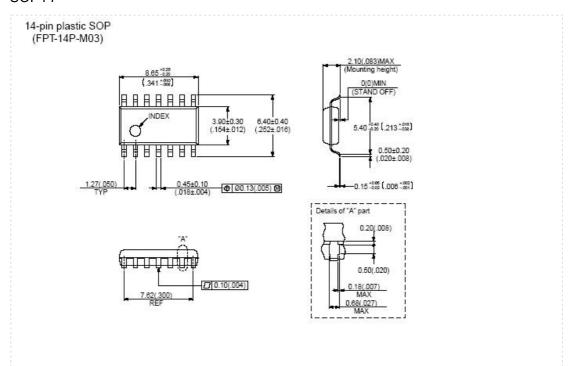
SO24

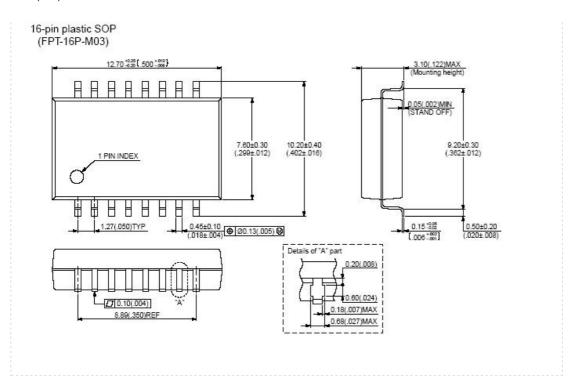


SO28

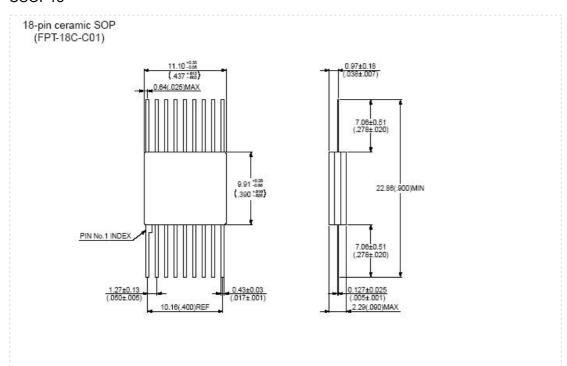


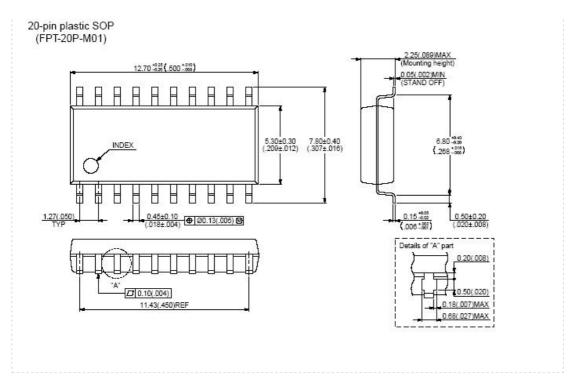


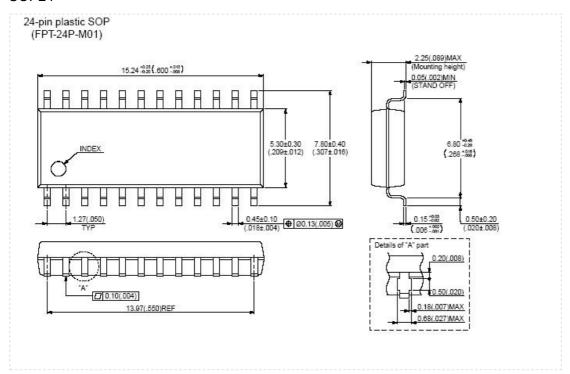


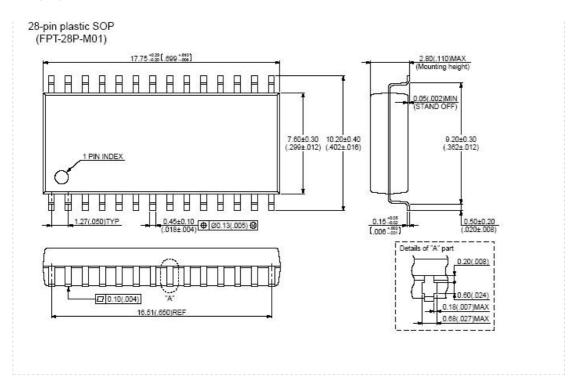


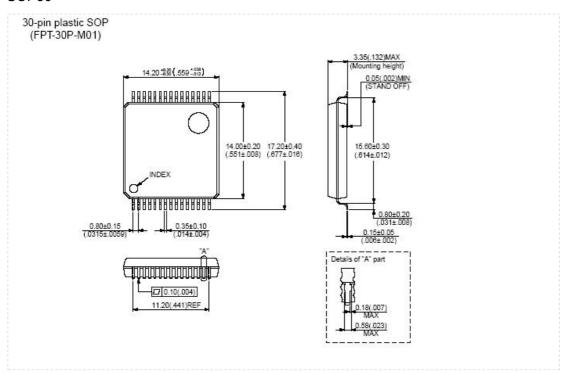
CSOP18

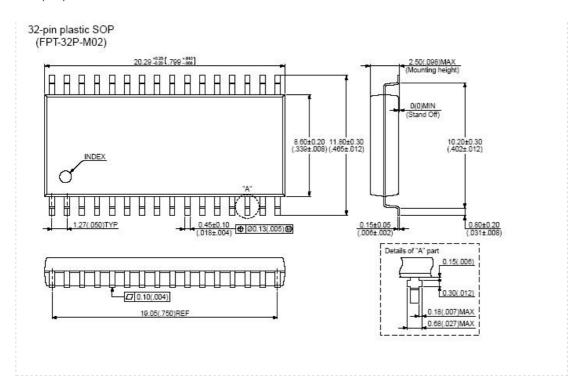


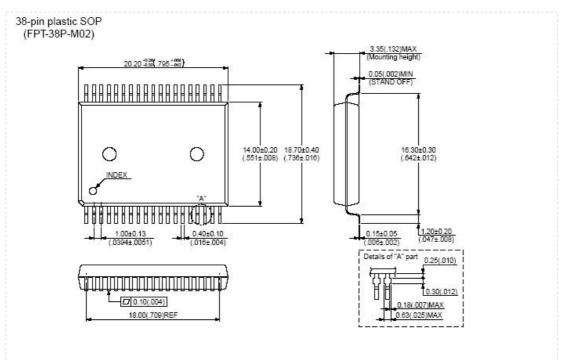


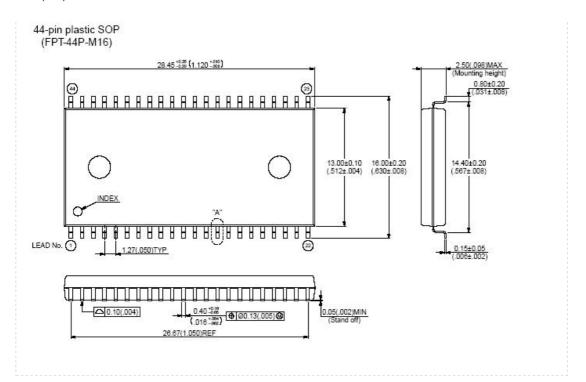


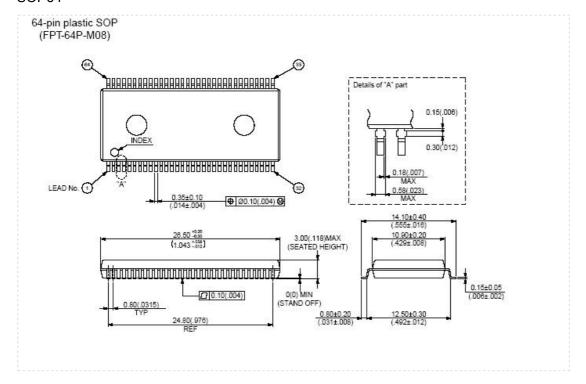






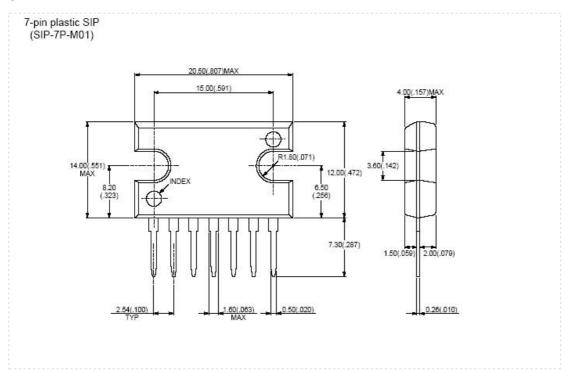




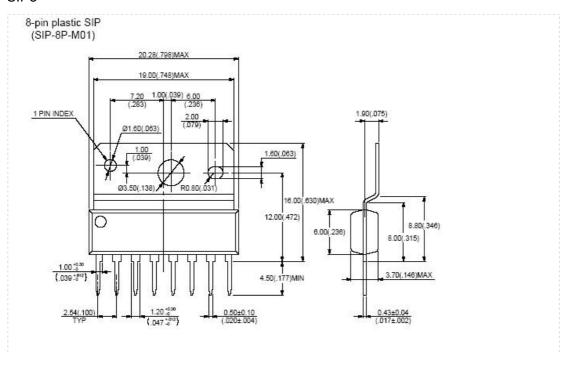


Корпус SIP. Чертежи корпусов импортных микросхем.

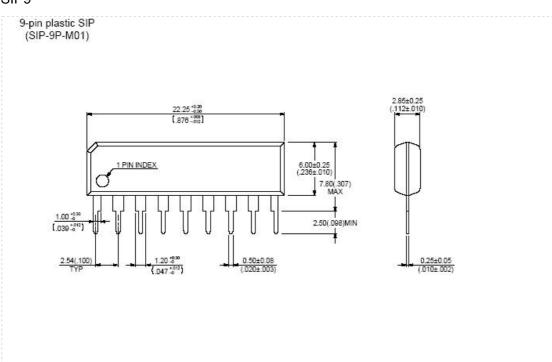
SIP7



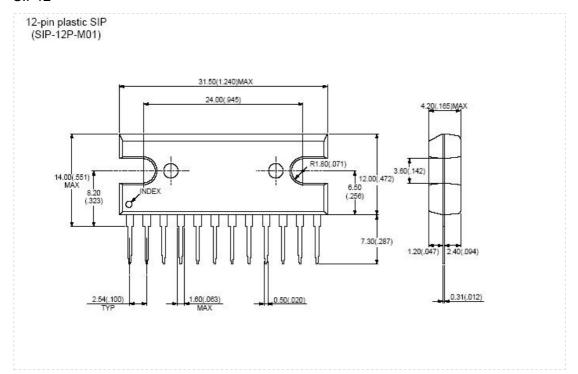
SIP8



SIP9

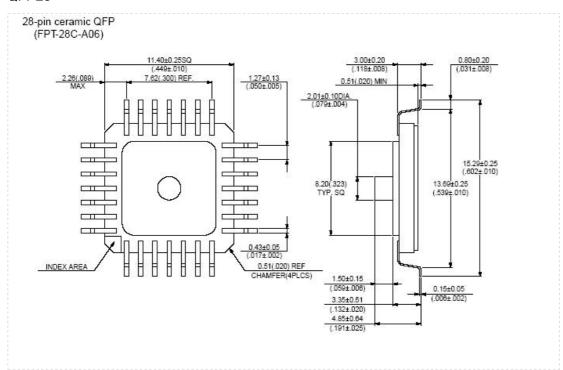


SIP12



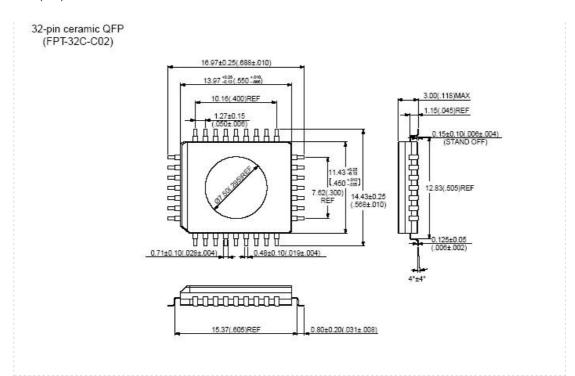
Корпуса QFP, LQFP, TQFP. Чертежи корпусов импортных микросхем.

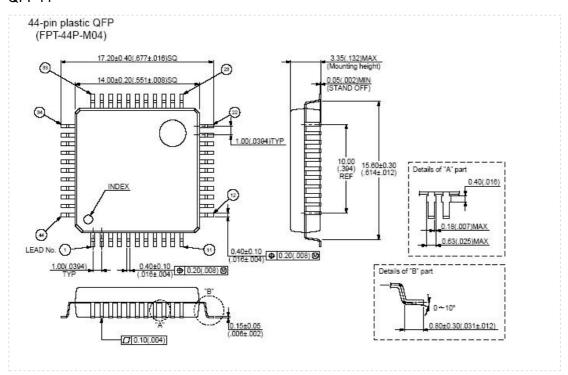
QFP28

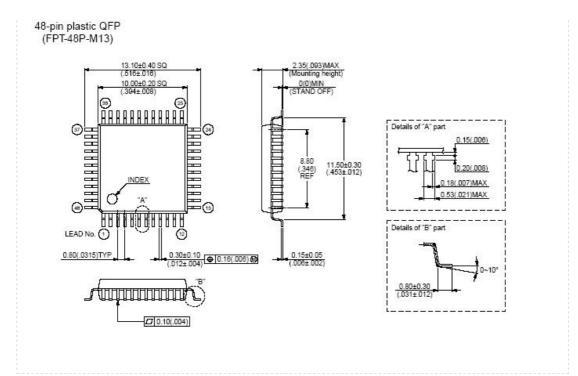


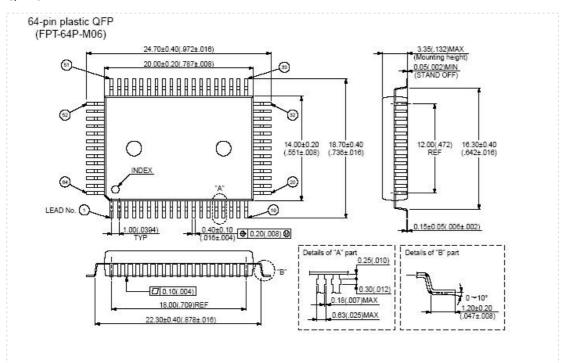
QFP32

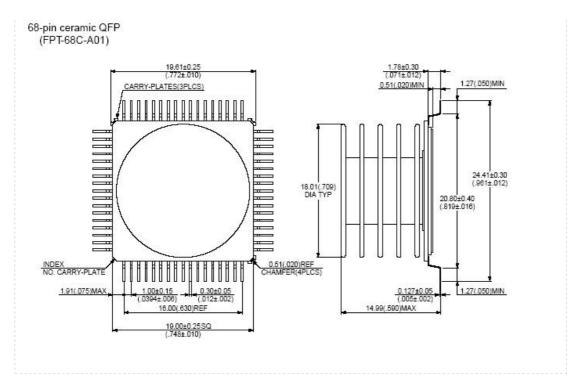
радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ

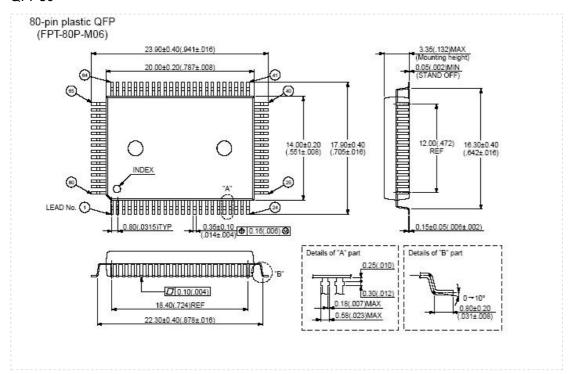


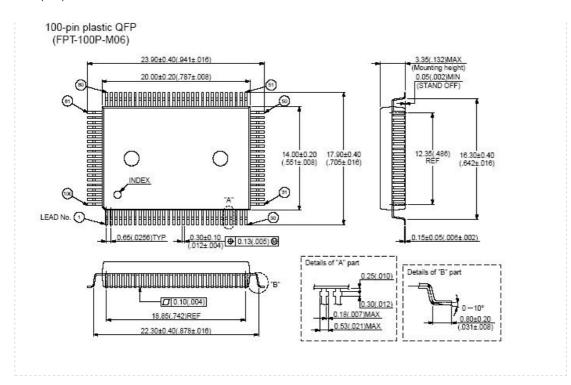


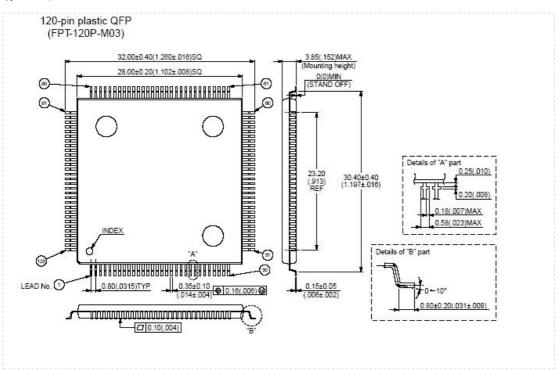


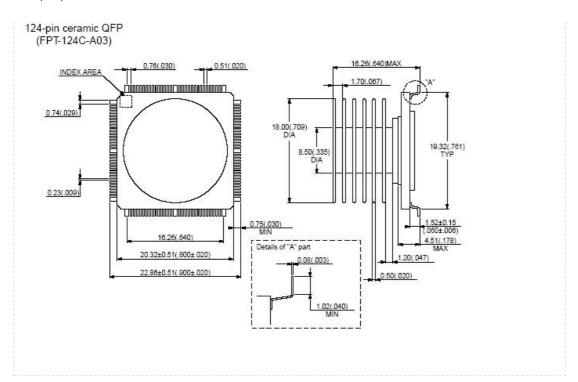


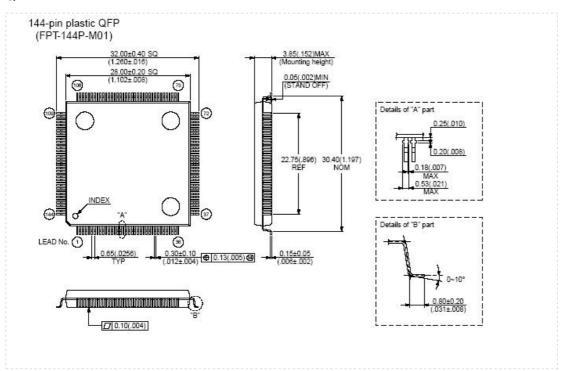


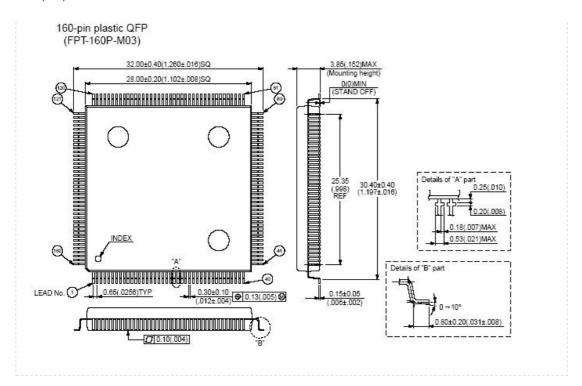


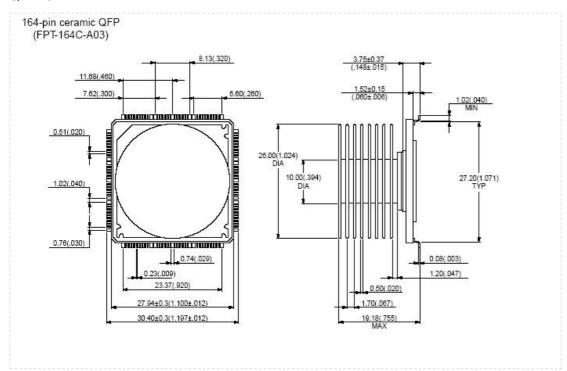


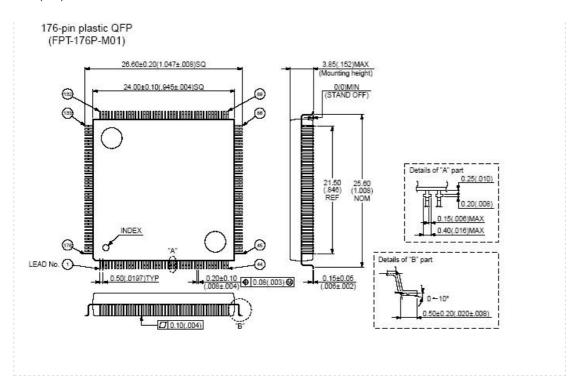


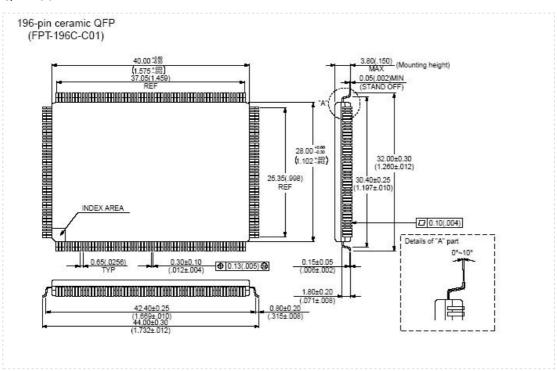


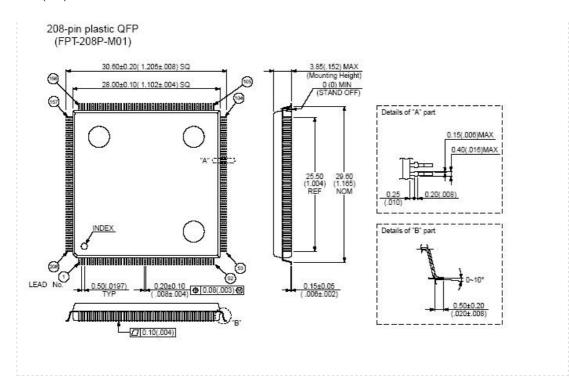




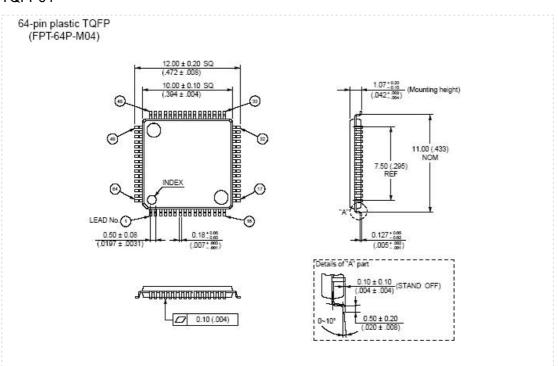




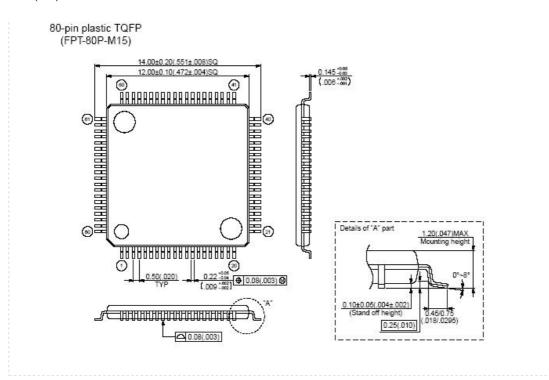




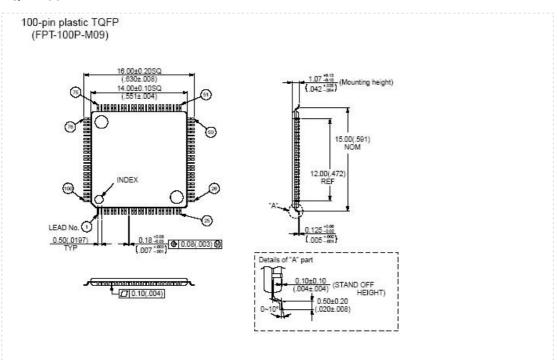
TQFP64



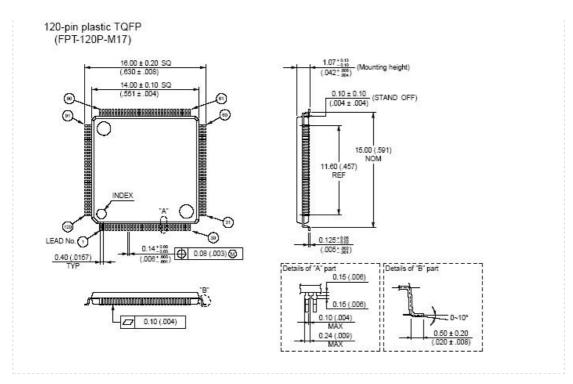
TQFP80



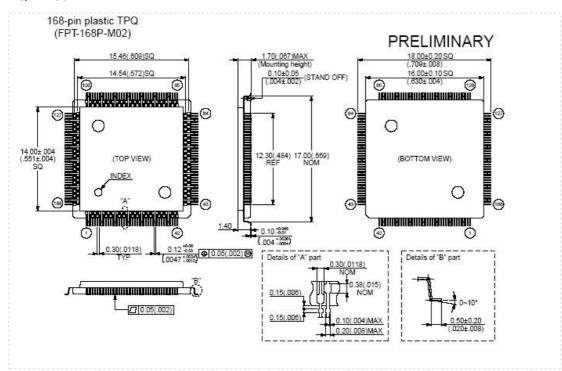
TQFP100

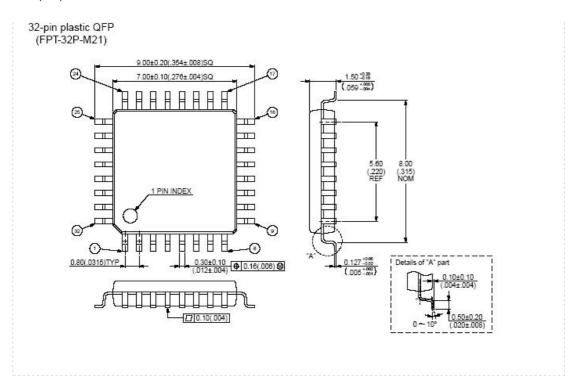


TQFP120

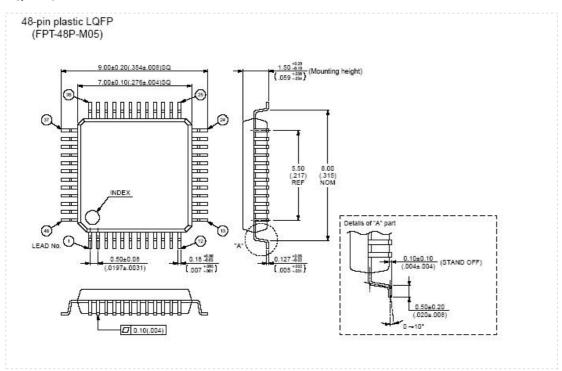


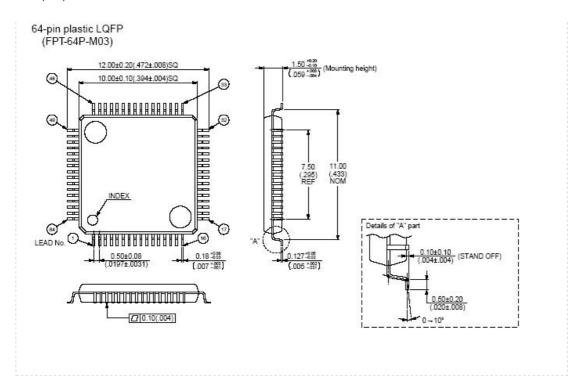
TQFP168



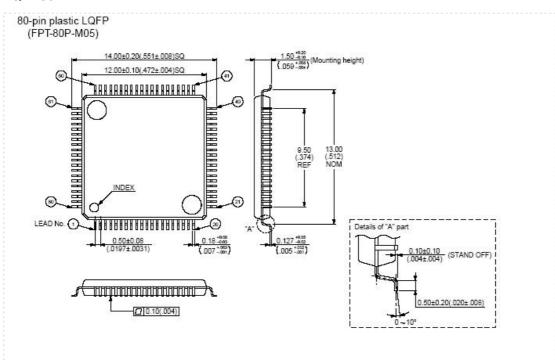


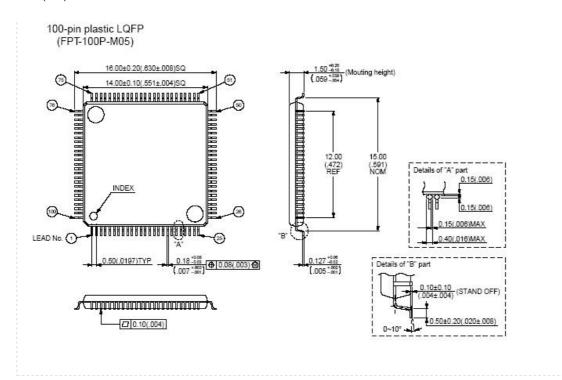
LQFP48



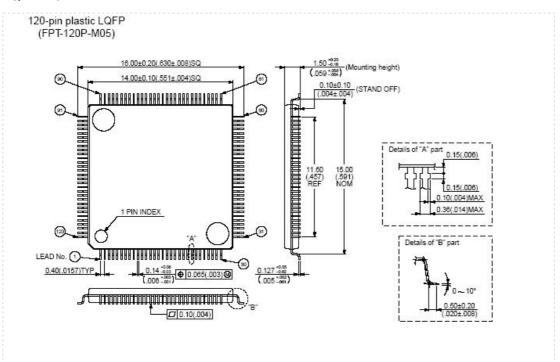


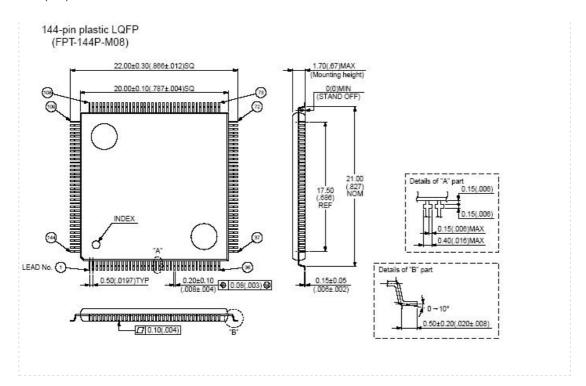
LQFP80





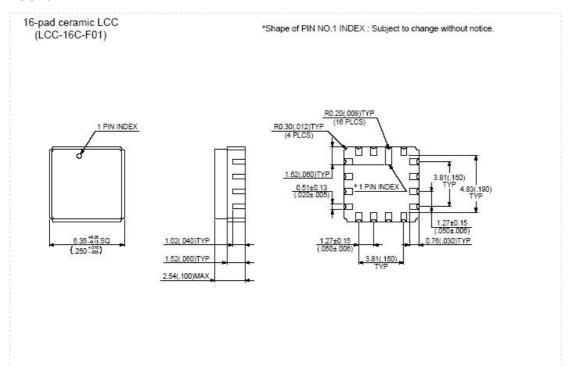
LQFP120



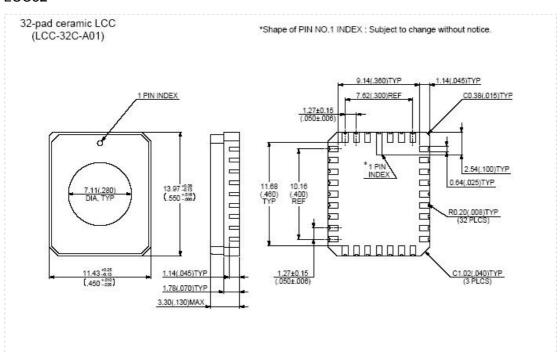


Корпус LCC. Чертежи корпусов импортных микросхем.

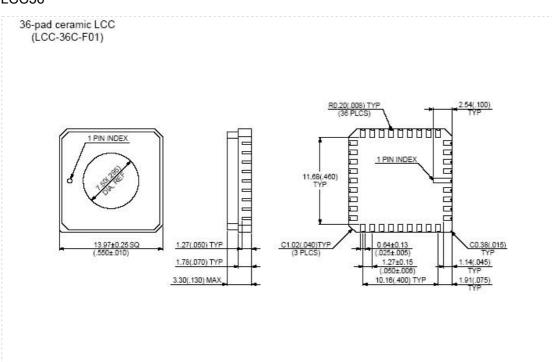
LCC16



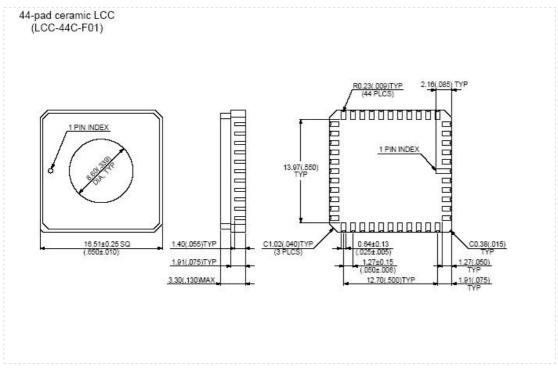
LCC32



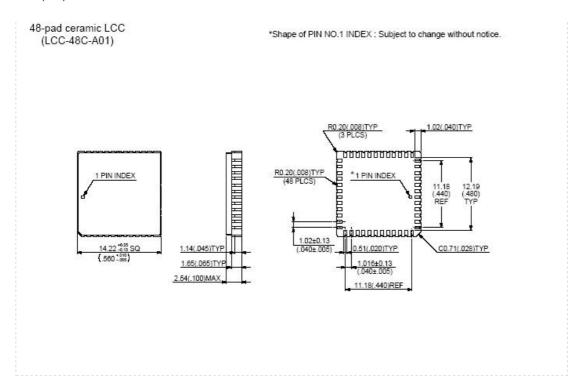
LCC36



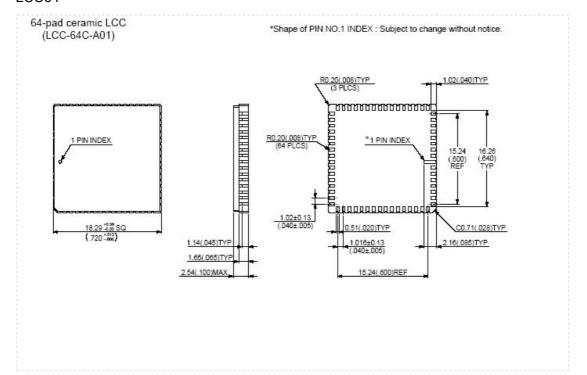
LCC44



LCC48

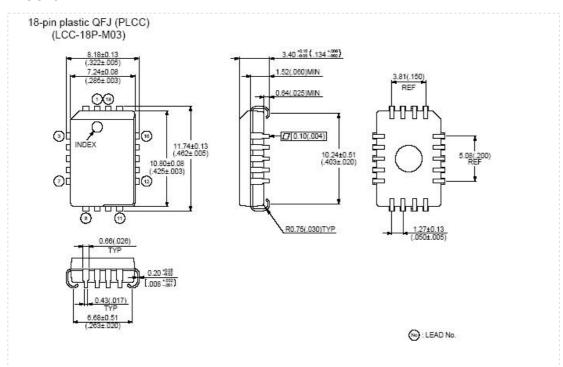


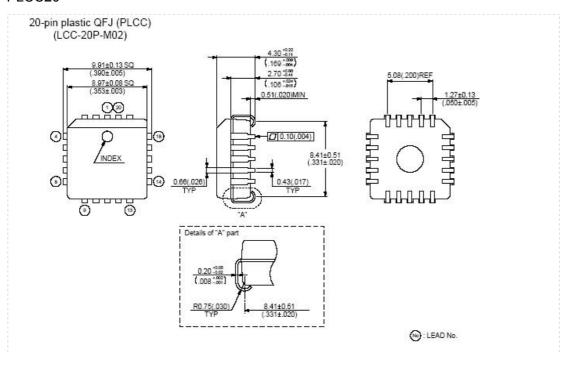
LCC64



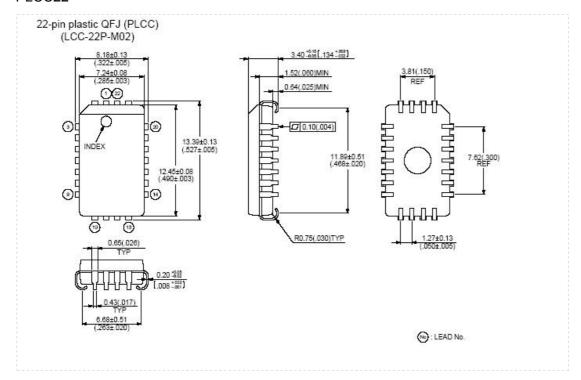
Корпус PLCC. Чертежи корпусов импортных микросхем.

PLCC18

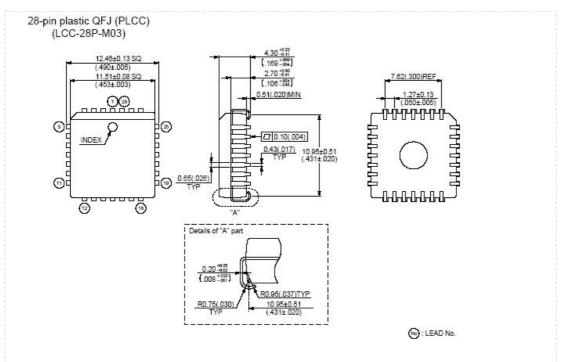


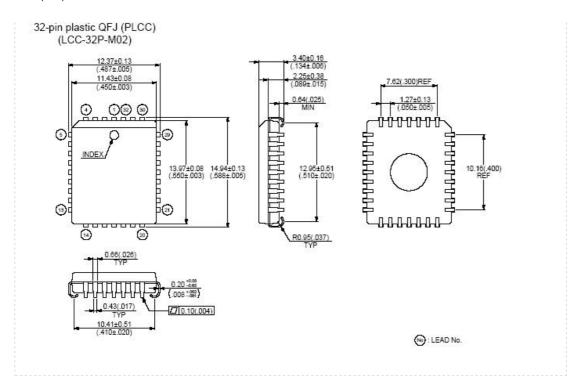


PLCC22

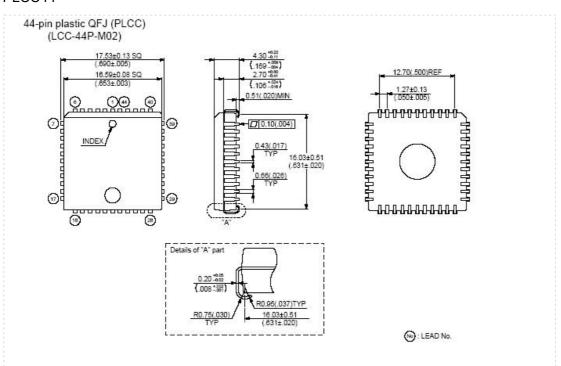


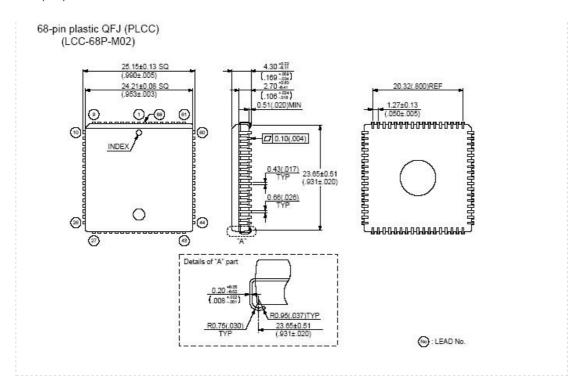
PLCC28

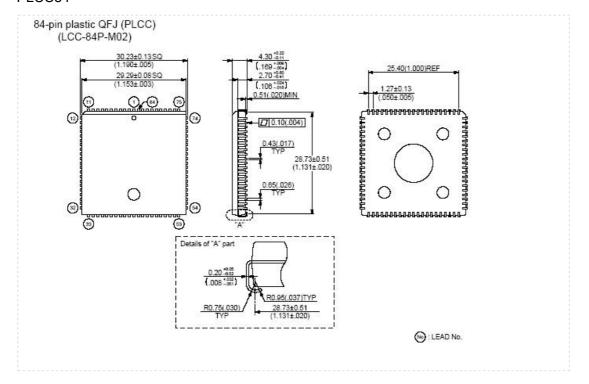




PLCC44

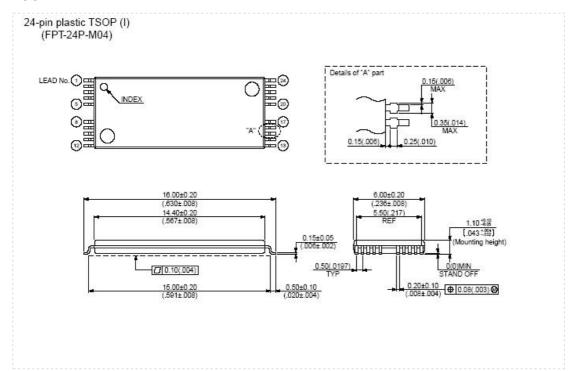


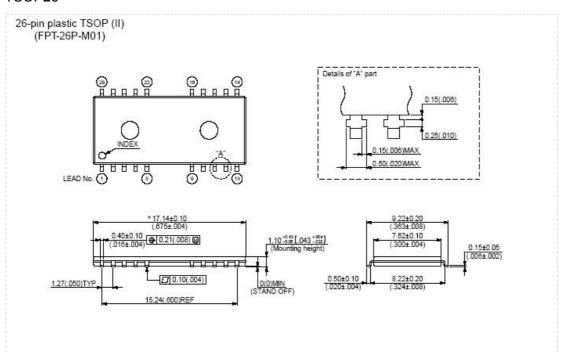


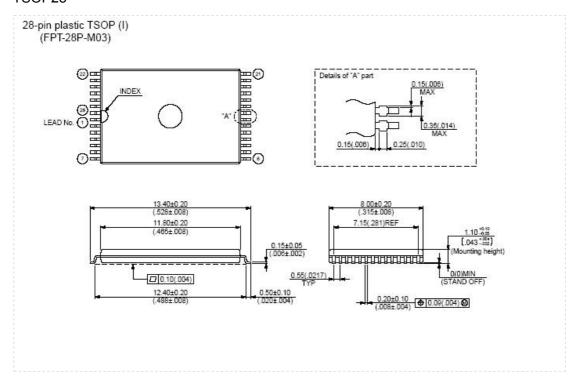


Корпус TSOP. Чертежи корпусов импортных микросхем.

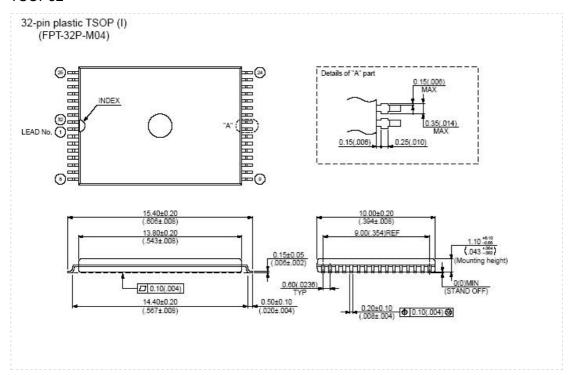
TSOP24

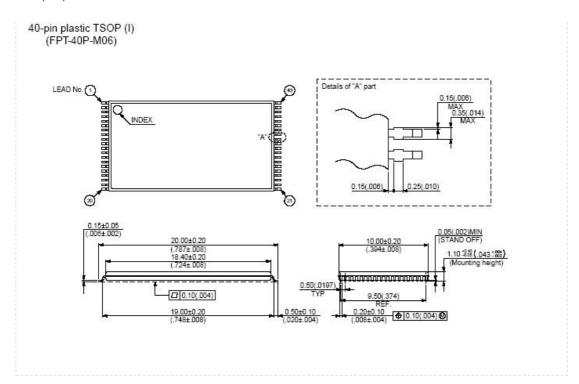


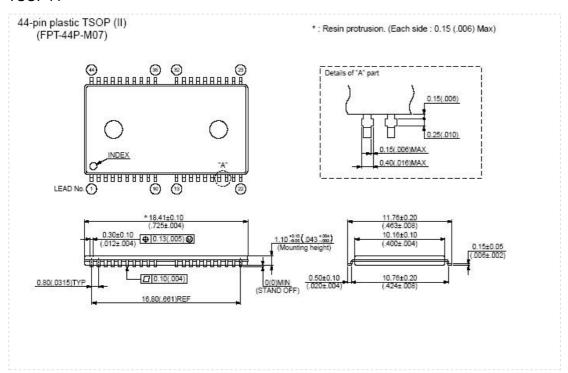


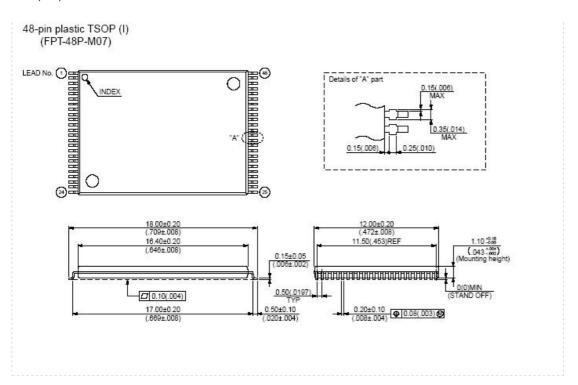


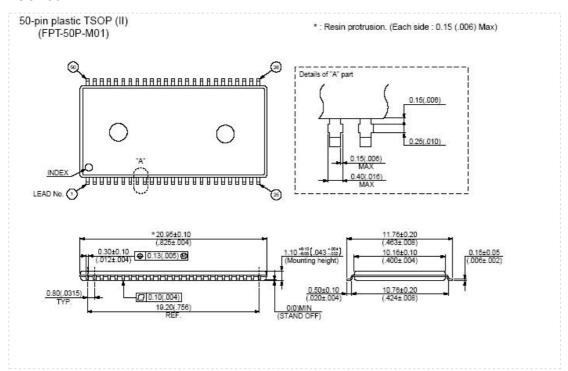
TSOP32

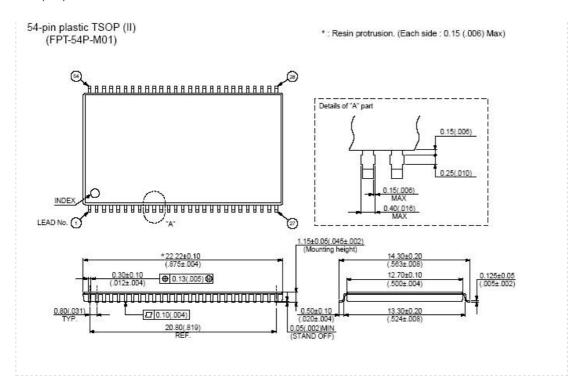


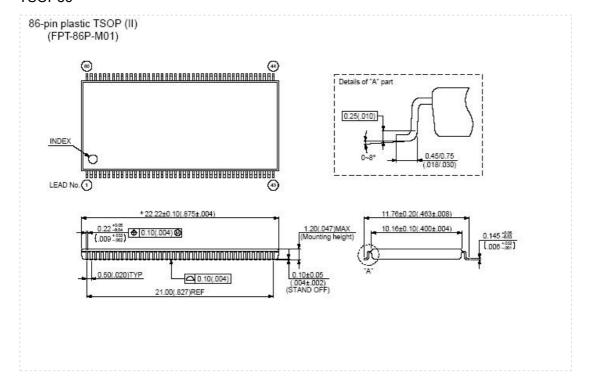






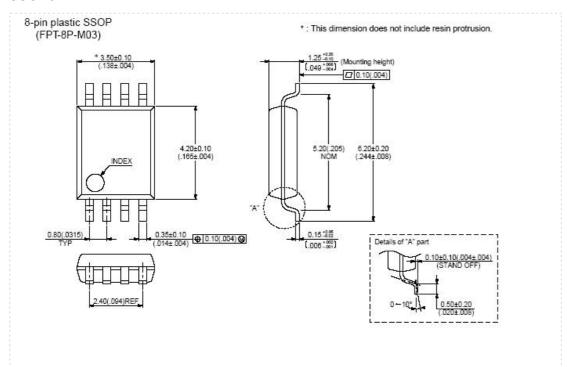




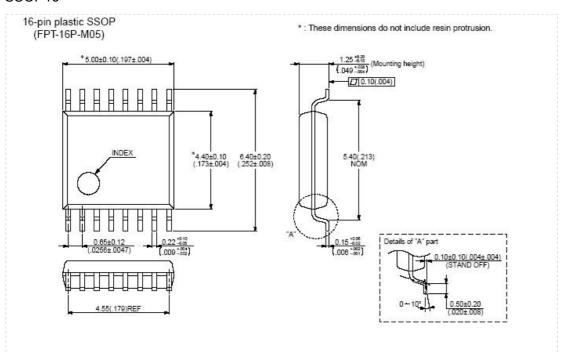


Корпус SSOP. Чертежи корпусов импортных микросхем.

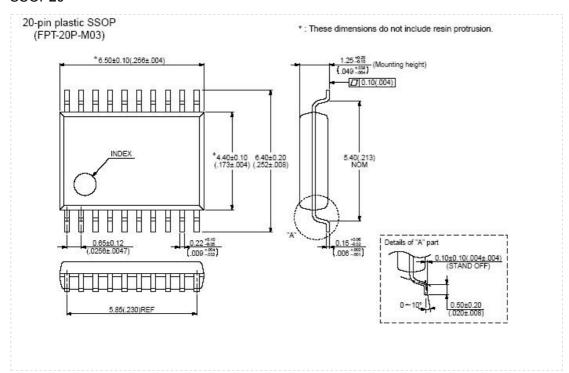
SSOP8



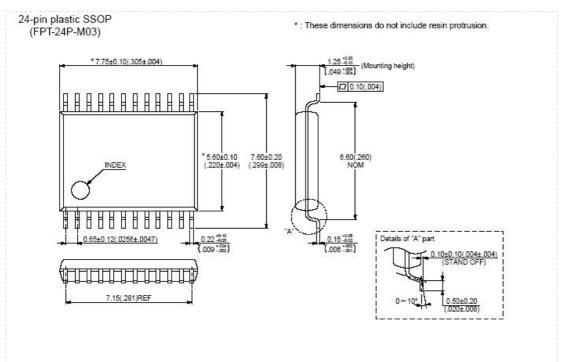
SSOP16



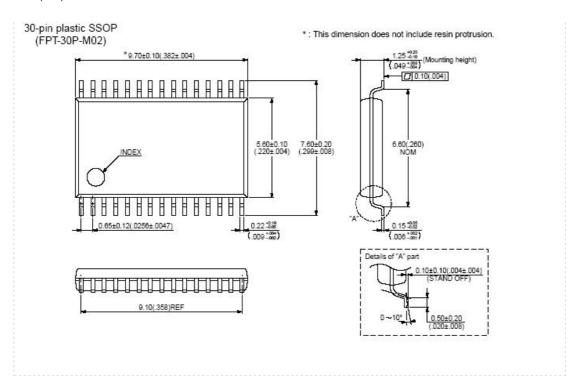
SSOP20



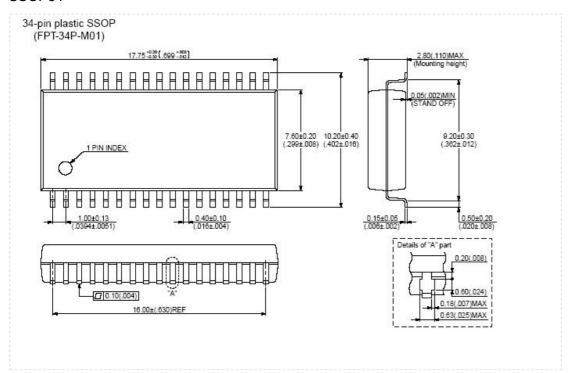
SSOP24



SSOP30



SSOP34



SSOP40

